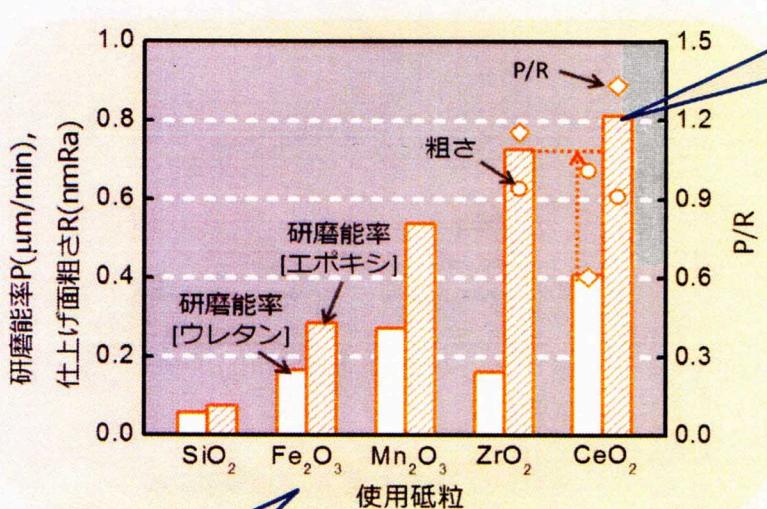


エポキシ樹脂研磨パッドの研磨特性

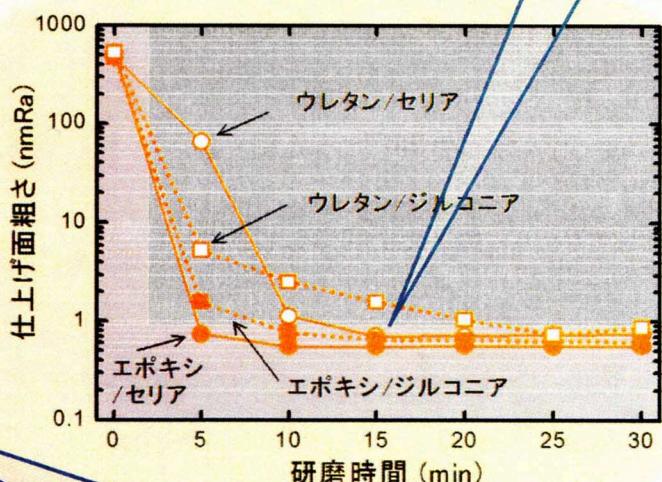
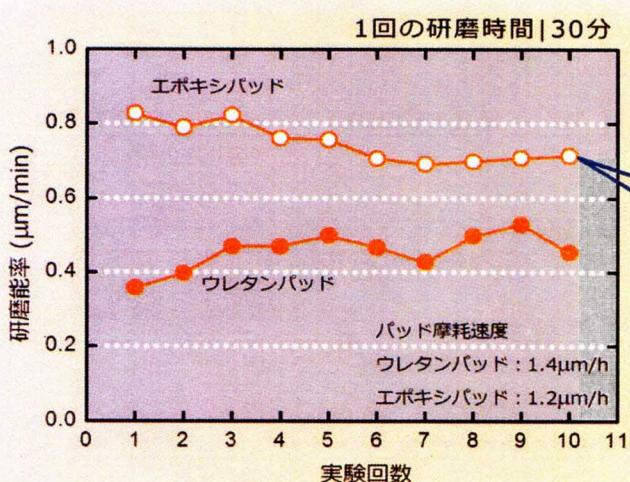


セリウム砥粒使用時

エポキシ樹脂研磨パッドは
ウレタン樹脂研磨パッド
使用時より
“研磨能率がおよそ**2倍**”

種々の砥粒使用時

エポキシ樹脂研磨パッドは
ウレタン樹脂研磨パッド
使用時より“研磨能率が**高い**”



5時間研磨後も

エポキシ樹脂研磨パッドは
ウレタン樹脂研磨パッド
使用時より“高い研磨能率を**維持**”

研磨実験条件

研磨装置 片面ラッピング装置 | ナノファクタ

砥粒 セリア [SHOROX A-10]

定盤径 $\phi 200 \text{ mm}$

スラリー 3 wt%, 25mL/min

ワーク ソーダガラス | $\phi 20\text{mm} \times t10\text{mm}$,
粗さ $0.4 \mu\text{mRa}$

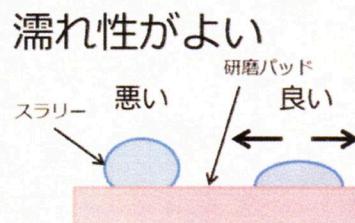
研磨圧力 20 kPa

研磨パッド ウレタンパッド, エポキシパッド

回転数 90 rpm
研磨時間 30 min

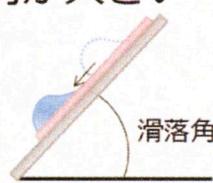


エポキシ樹脂研磨パッドの 研磨特性が良い要因

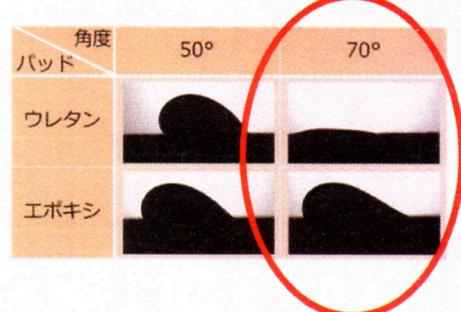


滑落角が大きい

研磨中に係る遠心力を重力に見立て砥粒の滞留性を評価



滑落角が高いほど良い



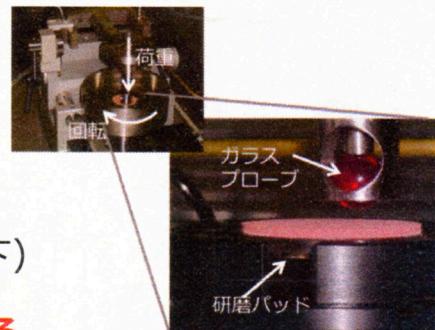
エポキシパッドは砥粒の滞留性が良い

○ボールオンディスク摩擦試験

●測定条件

- ・回転速度 10mm/s
- ・測定時間 約5分
- ・荷重 200g
- ・5mmガラスボール

●乾式測定およびスラリー滴下 (1分毎に1mL滴下)



エポキシパッド上には常にスラリーが滞留している

